

MT18Ex(C)

- ・ MicroThin は18 μ mのキャリア銅箔が付いている極薄銅箔です。
MicroThin is ultra thin foil with 18 μ m carrier foil.
- ・ 微細回路形成に有効で、L/S=20/20~35/35の回路形成が可能です。
Usable for fine pitch pattern L/S=20/20 - 35/35 formation.
- ・ コアレス基板工法に適しています。
Suitable for core-less process

用途/Application

- ・半導体パッケージ基板
/Semiconductor Package
- ・コアレス基板
/Core-less substrate

構成/Composition



生産拠点/Production Site

- ・日本 / Japan

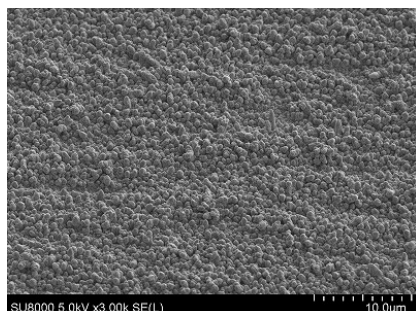
代表的特性値/Representative data

| | μ m | Area weight (g/m ²) | Laminate side Rz(μ m) | Tensile Strength (N/mm ²) | Elongation (%) | Peel Strength (kg/cm)@FR-4 |
|-----------|---------|------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|
| MT18Ex(C) | 2 | 24 | 2 | - | - | 1.2 |
| | 3 | 33 | 2 | - | - | 1.2 |
| | 5 | 51 | 2 | - | - | 1.2 |

※表中の数値は代表値です。保証値ではありません。
This is representative data, not guarantee.

※Peel Strength は、35 μ mまでメッキアップした後の測定値
Evaluated after plated up to 35 μ m

ラミ面/Laminate side



レジ面 resist side

